

2026年3月期 第2四半期（2025年7月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2025年10月31日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2026年3月期 第2四半期 連結決算の概要

2025年10月31日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



損益状況（四半期）

（億円）

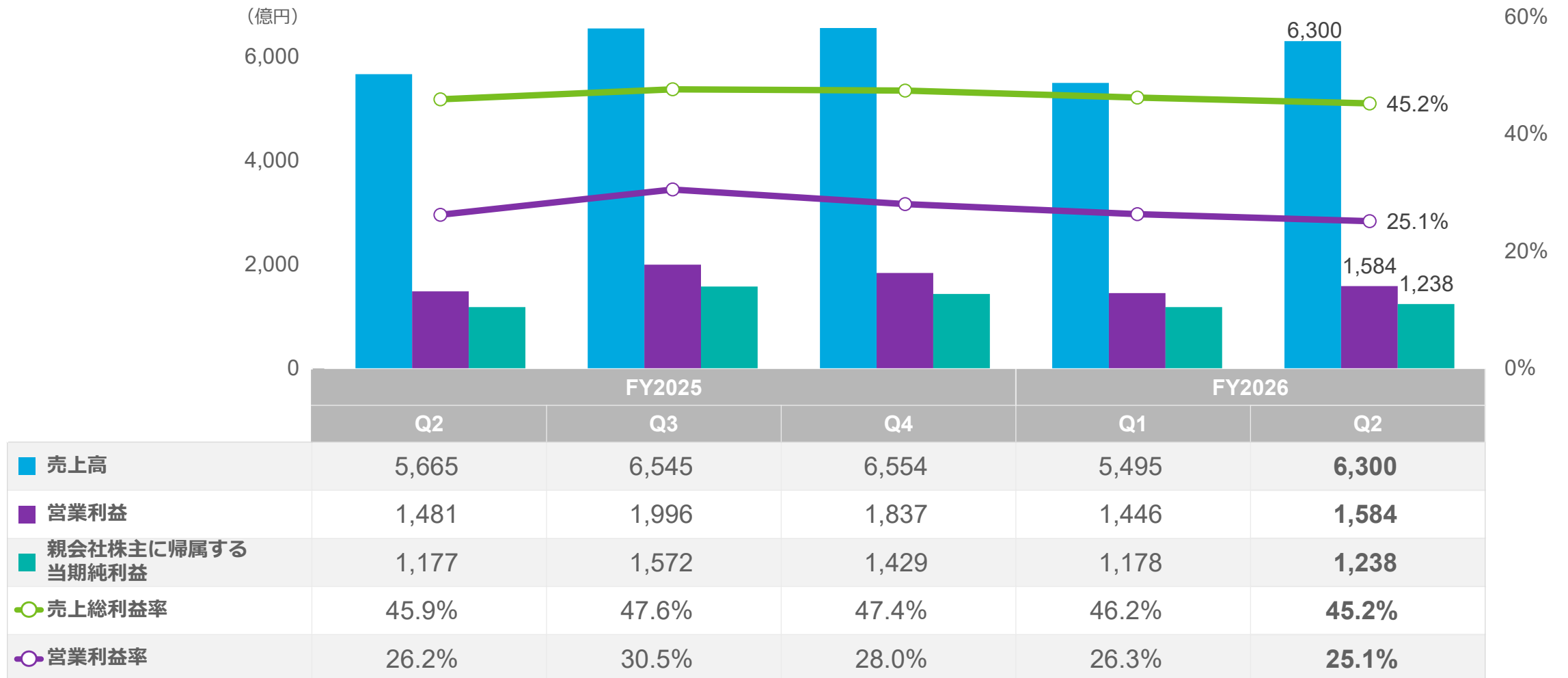
	FY2025			FY2026		vs. FY2026 Q1	vs. FY2025 Q2
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2		
売上高	5,665	6,545	6,554	5,495	6,300	+14.6%	+11.2%
売上総利益	2,599	3,117	3,105	2,539	2,848	+12.2%	+9.6%
売上総利益率	45.9%	47.6%	47.4%	46.2%	45.2%	-1.0pts	-0.7pts
販管費	1,117	1,121	1,267	1,092	1,264	+15.7%	+13.1%
営業利益	1,481	1,996	1,837	1,446	1,584	+9.5%	+6.9%
営業利益率	26.2%	30.5%	28.0%	26.3%	25.1%	-1.2pts	-1.1pts
税金等調整前当期純利益	1,536	2,001	1,851	1,519	1,610	+6.0%	+4.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,177	1,572	1,429	1,178	1,238	+5.1%	+5.2%
研究開発費	620	618	727	621	726	+17.0%	+17.1%
設備投資額	533	502	346	528	912	+72.7%	+71.1%
減価償却費	145	160	183	171	191	+11.4%	+31.8%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

3. FY2025は2024年4月～2025年3月の会計年度を指しています。FY2026は2025年4月～2026年3月の会計年度を指しています。

損益状況（四半期）



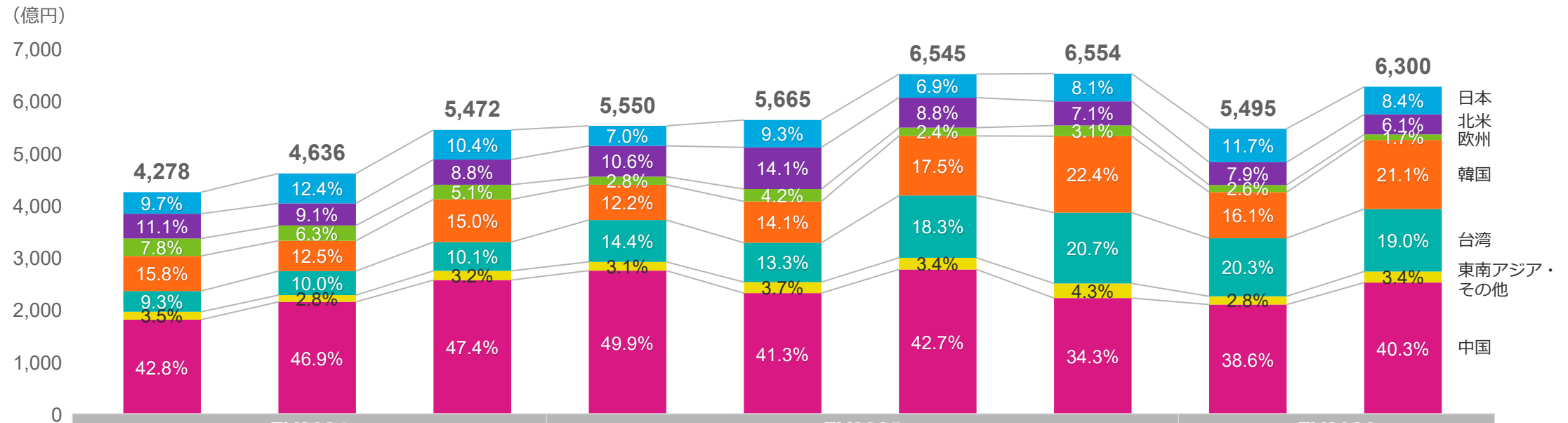
損益状況（半期）

（億円）

	FY2025		FY2026	vs. FY2025 H2	vs. FY2025 H1	(ご参考) 7月31日発表 FY2026 H1 予想
	H1	H2	H1			
売上高	11,216	13,099	11,796	-9.9%	+5.2%	11,500
売上総利益 売上総利益率	5,239 46.7%	6,223 47.5%	5,388 45.7%	-13.4% -1.8pts	+2.8% -1.0pts	5,270 45.8%
販管費	2,100	2,389	2,357	-1.3%	+12.2%	2,390
営業利益 営業利益率	3,139 28.0%	3,834 29.3%	3,031 25.7%	-20.9% -3.6pts	-3.4% -2.3pts	2,880 25.0%
税金等調整前当期純利益	3,208	3,852	3,129	-18.8%	-2.5%	2,930
親会社株主に帰属する当期純利益	2,439	3,002	2,416	-19.5%	-0.9%	2,240
研究開発費	1,154	1,345	1,348	+0.2%	+16.7%	1,400
設備投資額	773	848	1,440	+69.8%	+86.4%	-
減価償却費	277	344	362	+5.3%	+30.9%	-

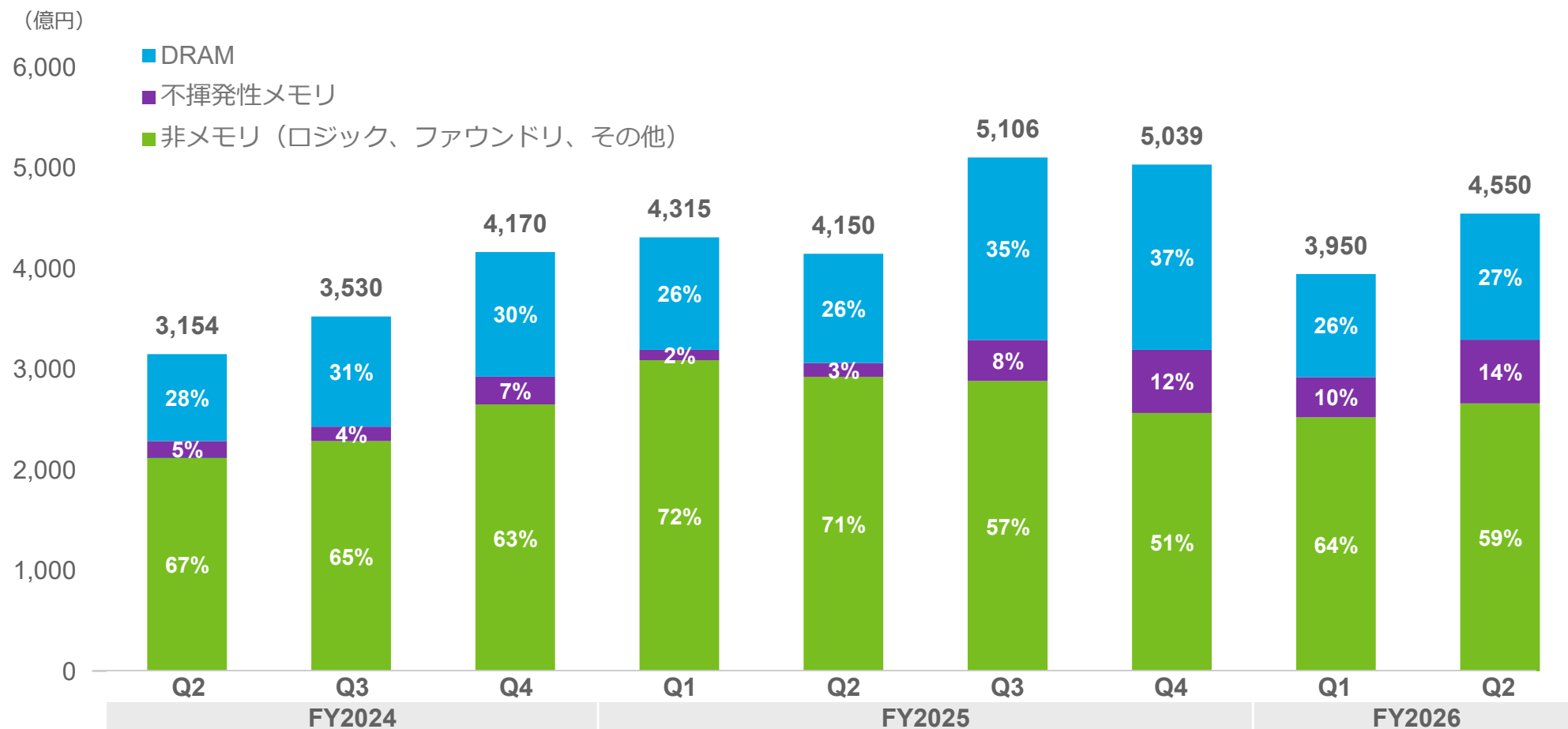
1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

地域別売上高構成比（四半期）



	FY2024			FY2025				FY2026	
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
日本	412	574	567	385	526	453	534	643	529
北米	474	421	483	590	799	577	462	434	384
欧州	335	294	281	155	238	157	203	140	108
韓国	674	582	820	678	795	1,145	1,470	883	1,325
台湾	399	463	552	800	753	1,193	1,358	1,115	1,197
東南アジア・その他	151	127	175	170	212	223	278	156	213
中国	1,829	2,172	2,591	2,770	2,339	2,794	2,246	2,121	2,541

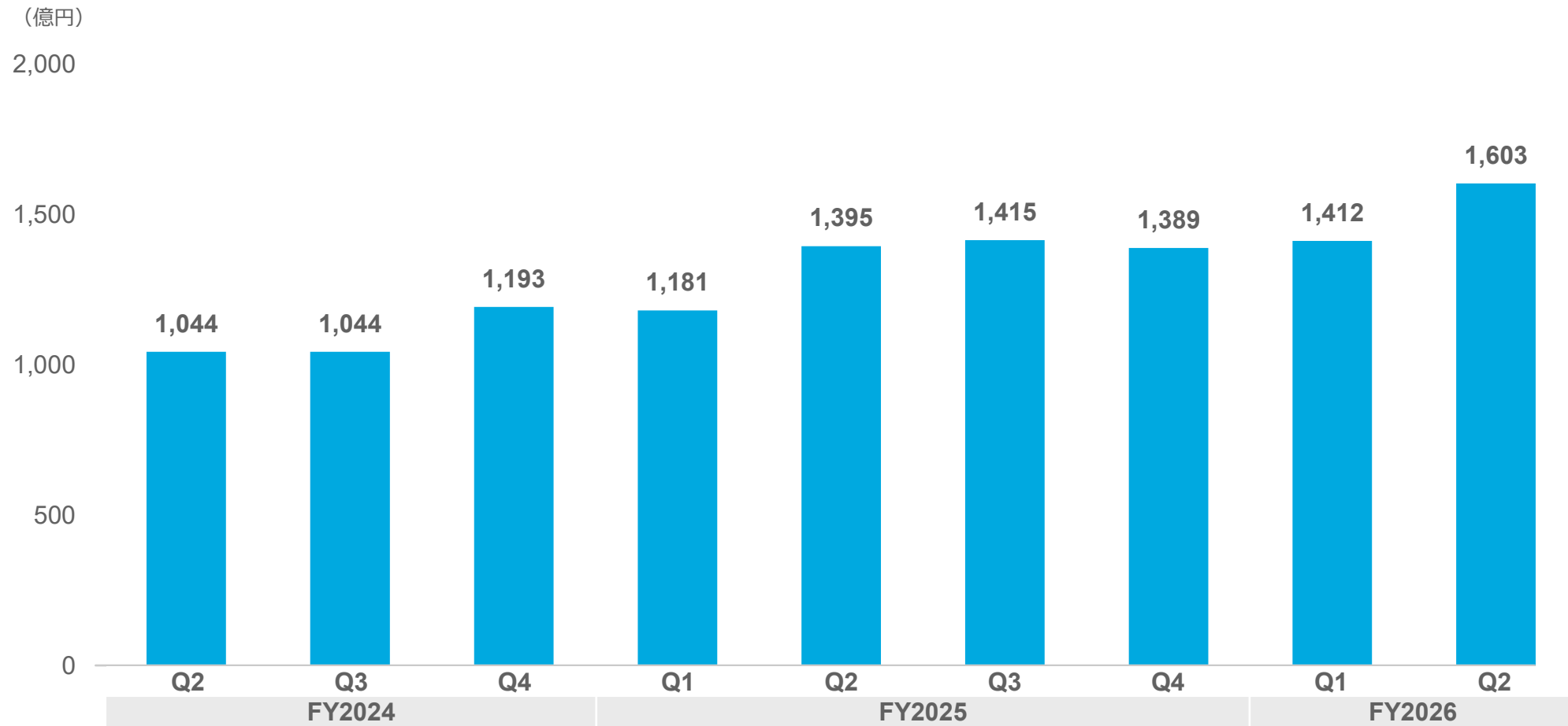
SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



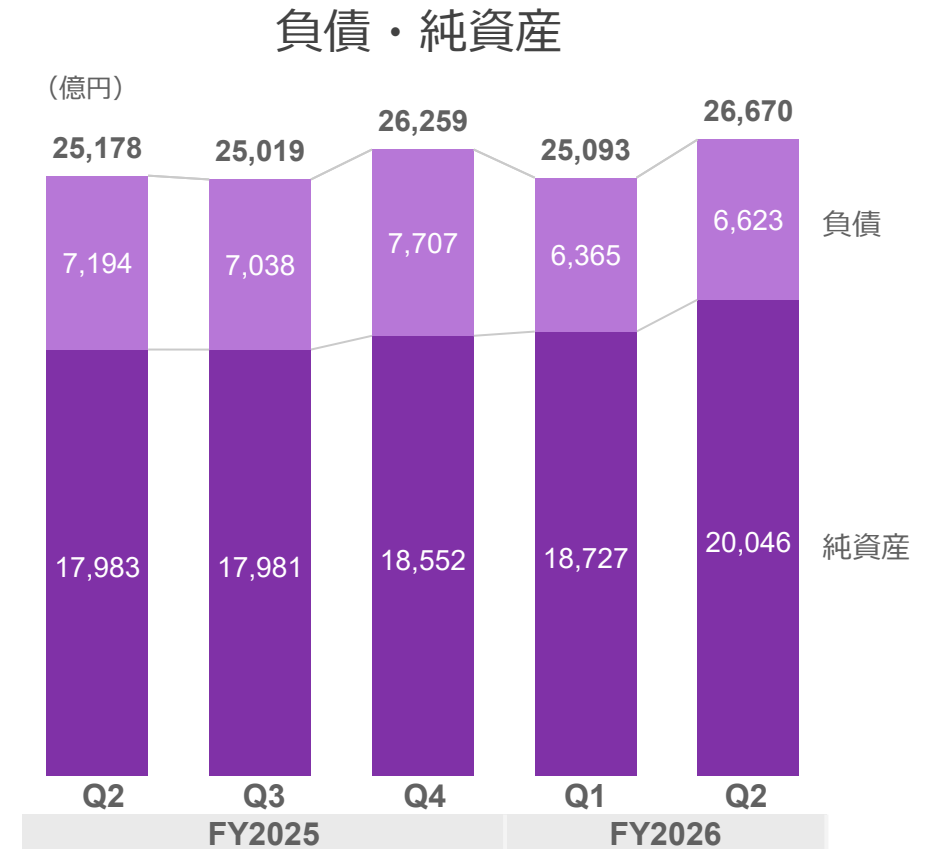
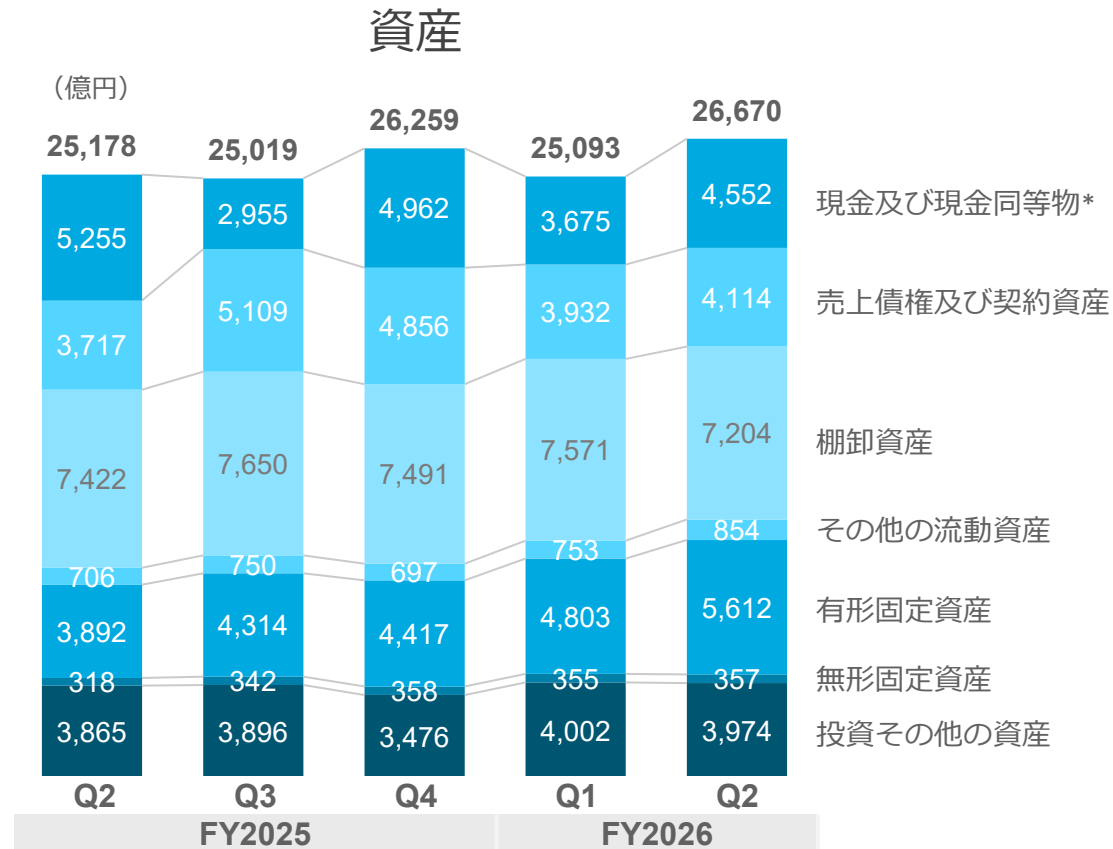
1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置

2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

フィールドソリューション売上高（四半期）

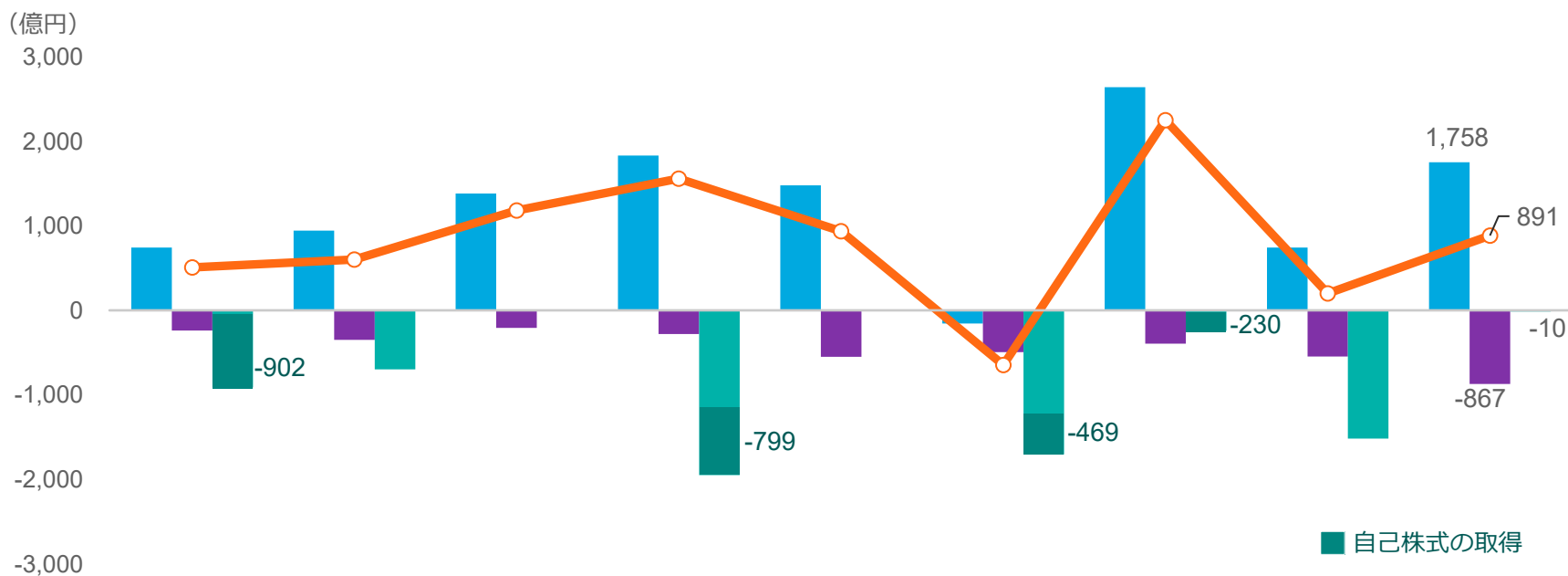


貸借対照表（四半期）



*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2024			FY2025				FY2026	
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
■ 営業キャッシュ・フロー	748	950	1,390	1,837	1,486	-150	2,648	749	1,758
■ 投資キャッシュ・フロー ^{*1}	-234	-344	-203	-273	-544	-490	-389	-541	-867
■ 財務キャッシュ・フロー	-908	-693	-6	-1,944	-6	-1,701	-235	-1,511	-10
○ フリーキャッシュ・フロー ^{*2}	514	606	1,187	1,564	941	-641	2,258	207	891
手元資金残高 ^{*3}	3,626	3,524	4,725	4,385	5,255	2,955	4,962	3,675	4,552

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

事業環境および業績予想

2025年10月31日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



事業環境（2025年10月時点でのWFE市場の見方）

- CY2025：\$115B程度と予測 <変更なし>

AI向けを中心とした最先端Logicと先端DRAMが投資を牽引。
NANDは回復基調も、成熟世代向けは軟調

- 今後、旺盛なAIサーバー需要に牽引され、先端半導体向け投資は拡大傾向が続くと見込む

- DRAM：HBMのみならず汎用DRAM向け投資も急増。来年以降も二桁成長が期待できる
- NAND：SSD向け需要により顧客の稼働率が上昇中
- ロジック/ファウンドリ：先端向け投資は今後もさらに増加。
アドバンスドパッケージングも進展
- 成熟世代デバイス：現状と同規模程度のWFEが継続すると予測

来年以降、付加価値の高い最新装置の需要拡大を見込む

拡大するTELの事業機会

微細化×異種デバイス集積

Etch

>5,000億円

- DRAM配線工程エッチング装置：
特に配線層数の多いHBM向け投資増加により事業機会が拡大。
2030年までに累計5,000億円以上の売上を見込む

**Bonder
Laser**

>5,000億円

- ボンダーをはじめとした3次元実装装置：
すべてのアプリケーションにおいて急拡大。
2030年までに累計5,000億円以上の売上を見込む

Prober

**CAGR
>15%**

- AI・HPC向けプローバ：
さらなるテスト時間や工程数増加に伴いCAGR15%以上の成長を見込む（CY2025～CY2030）

**Die Prober
PECVD**

**SAM
+10%**

- ダイプローバ：
顧客との開発評価合意。プローバ市場の10～15%のSAM創出
- 埋め込み膜用 枚葉プラズマCVD：
PECVD市場の約10%。複数顧客にて評価進捗中

2026年3月期 業績予想

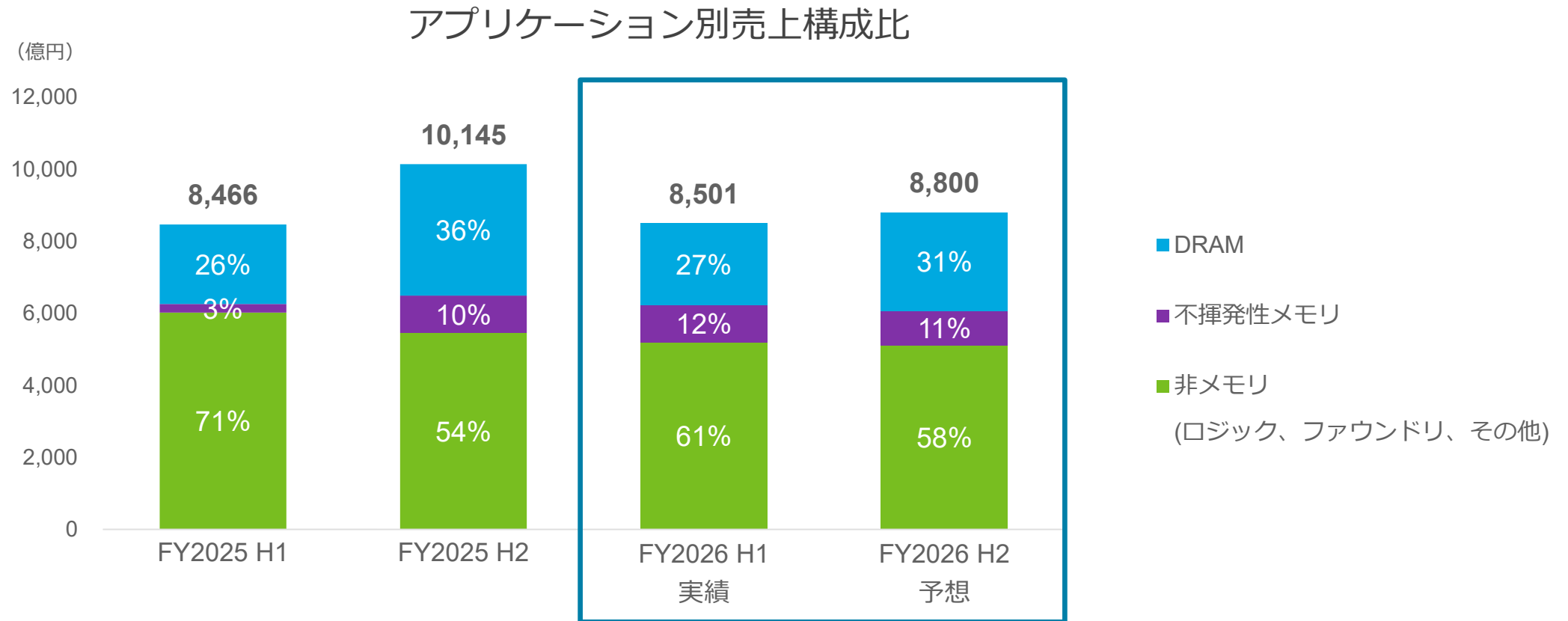
(億円)

	FY2025 (実績)	FY2026					ご参考：FY2026 (7/31時点予想)	
		H1 (実績)	H2 (新予想)	通期 (新予想)	vs FY2025	通期修正額*	H2	通期
売上高	24,315	11,796	12,003	23,800	-2.1%	300	12,000	23,500
売上総利益 売上総利益率	11,462 47.1%	5,388 45.7%	5,401 45.0%	10,790 45.3%	-5.9% -1.8pts	130 -0.1 pts	5,390 44.9%	10,660 45.4%
販管費 研究開発費 研究開発費以外の販管費	4,489 2,500 1,989	2,357 1,348 1,009	2,572 1,551 1,021	4,930 2,900 2,030	+9.8% +16.0% +2.1%	-30 -50 20	2,570 1,550 1,020	4,960 2,950 2,010
営業利益 営業利益率	6,973 28.7%	3,031 25.7%	2,828 23.6%	5,860 24.6%	-16.0% -4.1pts	160 0.4pts	2,820 23.5%	5,700 24.3%
税金等調整前当期純利益	7,061	3,129	3,220	6,350	-10.1%	560	2,860	5,790
親会社株主に帰属する当期純利益	5,441	2,416	2,463	4,880	-10.3%	440	2,200	4,440
1株当たり当期純利益 (円)	1,182.40	527.31	-	1,064.77	-117.63	95.65	-	969.12

* 2025年7月31日に発表した通期業績予想からの修正額を示しています。

上期実績を踏まえ、通期の業績予想を修正。
保有株式の売却に伴う特別利益を反映

2026年3月期 SPE新規装置売上予想



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

最新業績予想に基づき、アプリケーション別売上構成予想を更新

2026年3月期 研究開発費・設備投資計画

第3開発棟
エッチング装置



宮城県黒川郡
2025年4月 竣工

プロセス開発棟
コータ/デベロッパ、洗浄装置



熊本県合志市
2025年10月 竣工

東北生産・物流センター
成膜装置



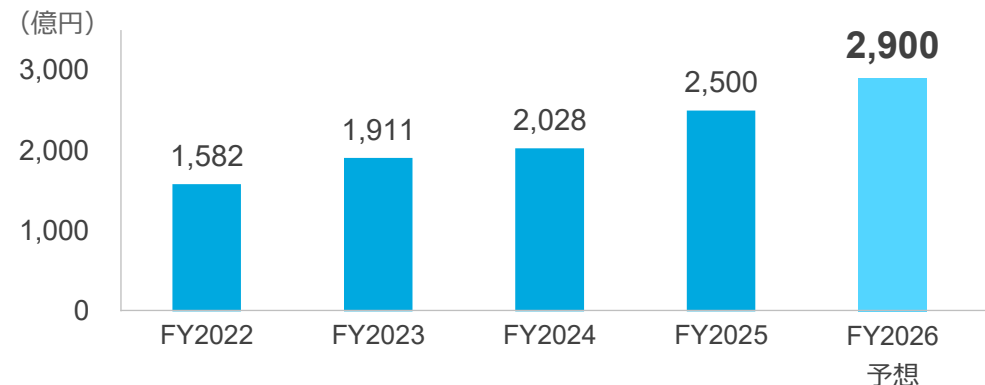
岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定

宮城生産革新センター
エッチング装置

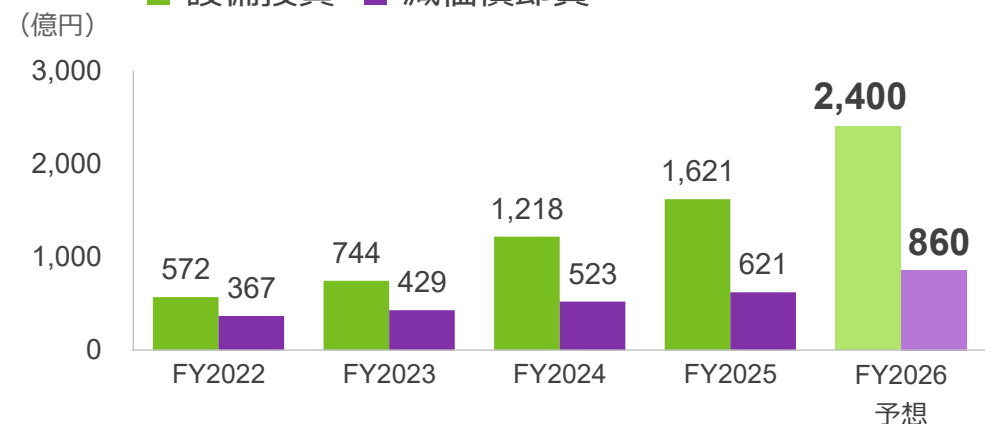


宮城県黒川郡
2027年夏 竣工予定

■ 研究開発費



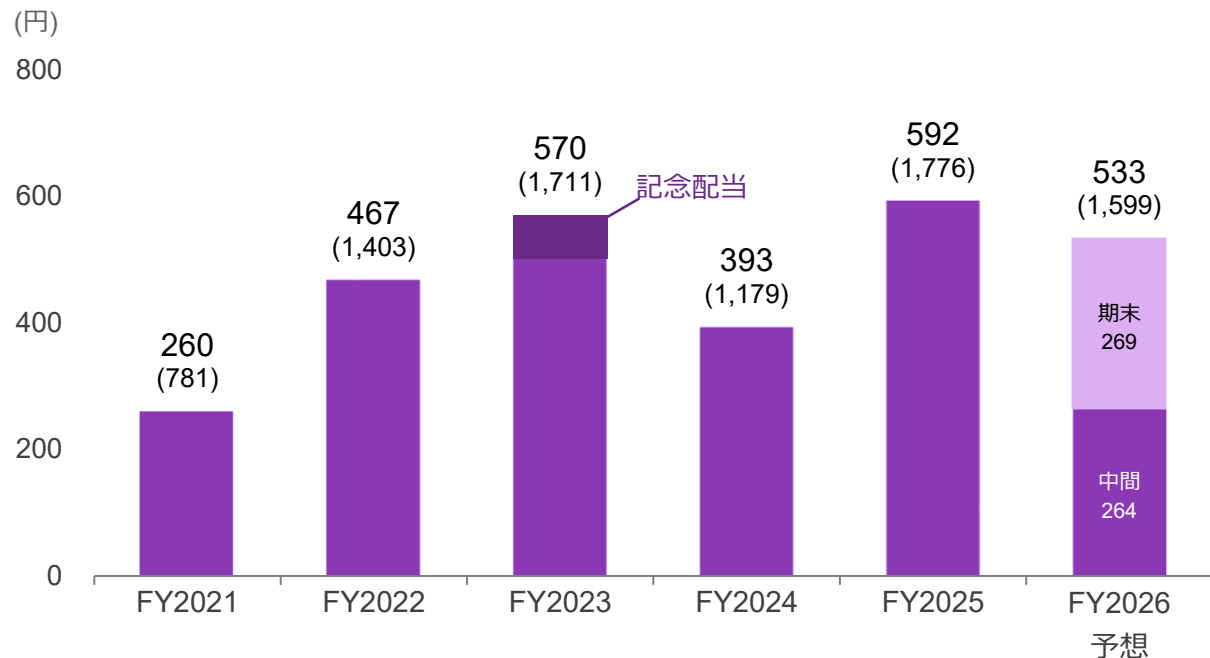
■ 設備投資 ■ 減価償却費



AIサーバー向け半導体が技術革新を牽引し、半導体の需要は拡大。
研究開発・設備投資は予定通り実施

2026年3月期 配当予想

1株当たり配当金



- FY2021～2023の1株当たり配当額は、FY2021の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

1株当たり通期配当は533円を予定



TOKYO ELECTRON